

明新學校財團法人明新科技大學 函

地址：30401新竹縣新豐鄉新興路1號
聯絡人：何宗穎
電子信箱：zyho@must.edu.tw
聯絡電話：(03)5593142分機3270
傳真電話：(03)5595142

受文者：國立大湖高級農工職業學校

發文日期：中華民國112年5月24日

發文字號：明新（半）字第1120005435號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件如說明一（1121200760_1_ATTCH1.pdf、1121200760_2_ATTCH2.pdf）

主旨：本校辦理111學年度教師產業研習「半導體封裝製程與設備實務培訓營」第二梯次培訓課程，誠摯邀請工程專業領域之大學及高中職教師，請轉知貴屬，並踴躍報名參加，請查照。

說明：

- 一、為提升教師多元實務專長，教育部特補助本校辦理半導體封裝製程與設備實務培訓營。課程內容有半導體封裝製程及設備實務操作，並由專業學者與業師共同授課。封裝製程主要講授傳統封裝、高階封裝及先進封裝製程等專業知識；設備實務則訓練晶圓切割機、固晶機及打線機的實務操作能力；QFN自動機台操作實務則有機台介紹、製程參數設定及機台運轉測試。誠摯邀請貴校教師踴躍參加，讓本研習活動的效益能擴及其他友校。研習課程內容請詳閱活動簡章（附件1）及活動海報（附件2）各1份。

二、研習相關資訊：

- （一）第二梯次研習時間：112年7月3日（星期一）至7月14

(星期五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分。

(二)研習地點：明新科技大學逢喜樓209教室、明新科技大學
半導體封裝測試類產線基地。

(三)參加培訓人數30人(名額有限滿額為止)。

三、報名方式：

(一)報名時間：112年6月25日截止

(二)報名網址：<https://forms.gle/4hipgy9nkyBj5VYs5>

四、報名洽詢：明新科技大學半導體學院類產線計畫辦公室何
宗穎助理，電話：(03)5593142分機3270

正本：各公私立高級職業學校、各公私立大專校院

副本：本校半導體學院、產學及技術移轉中心

